

1 2 3 4 5 6 7 8

A

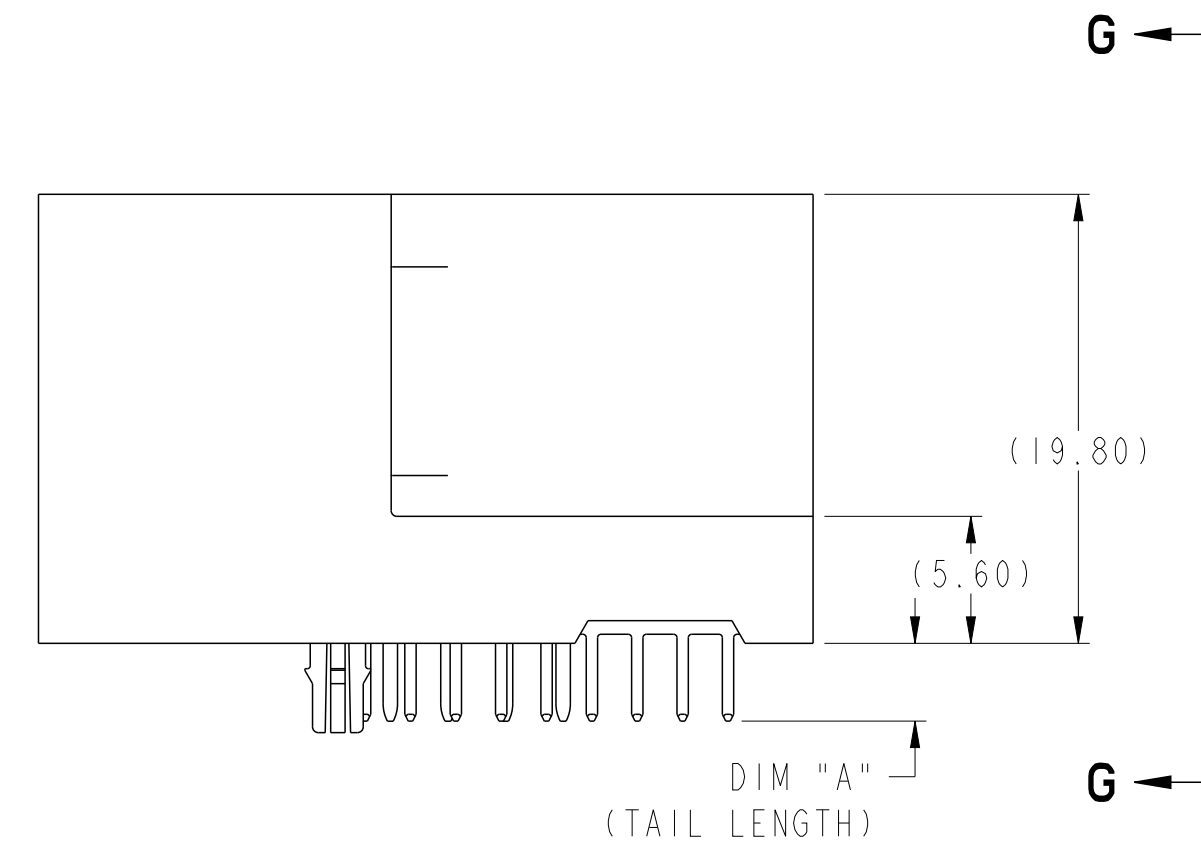
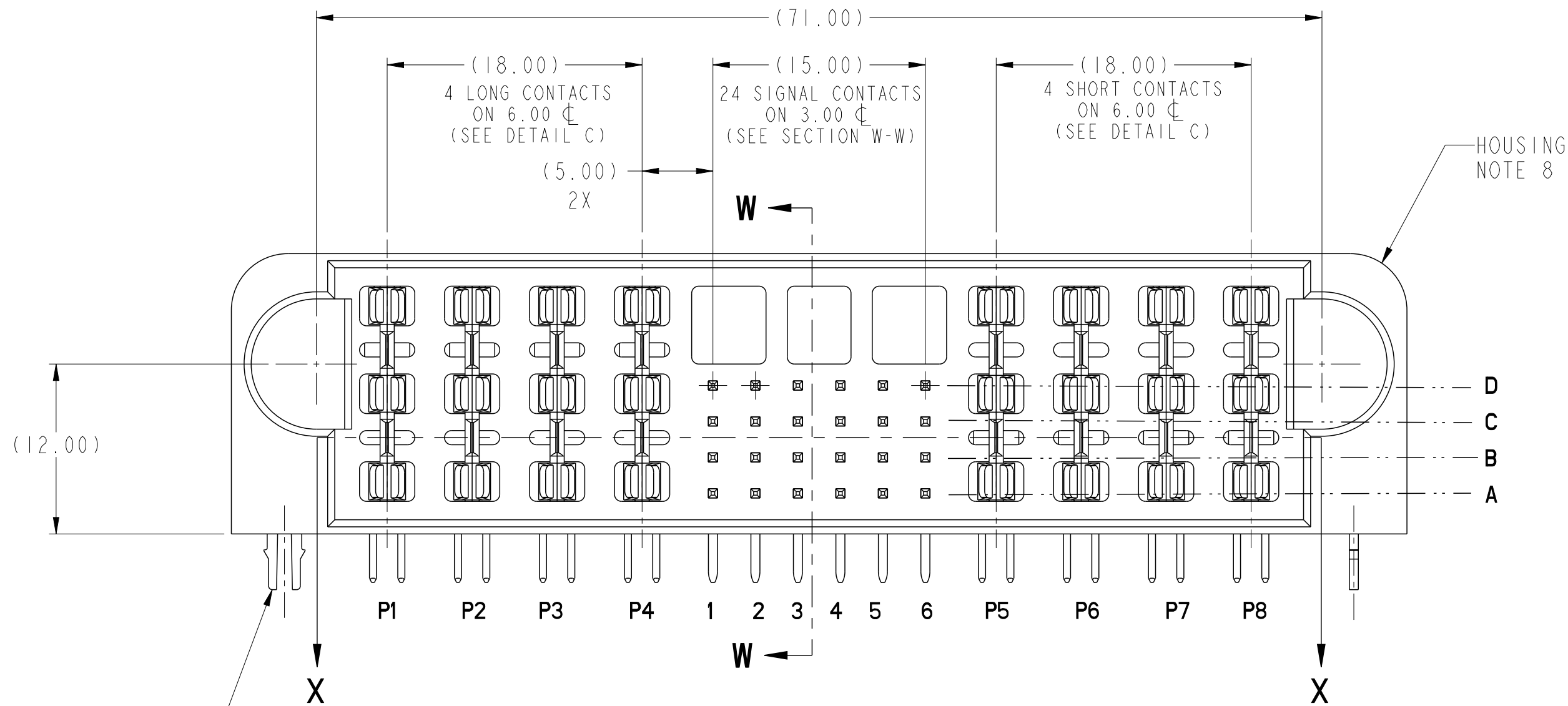
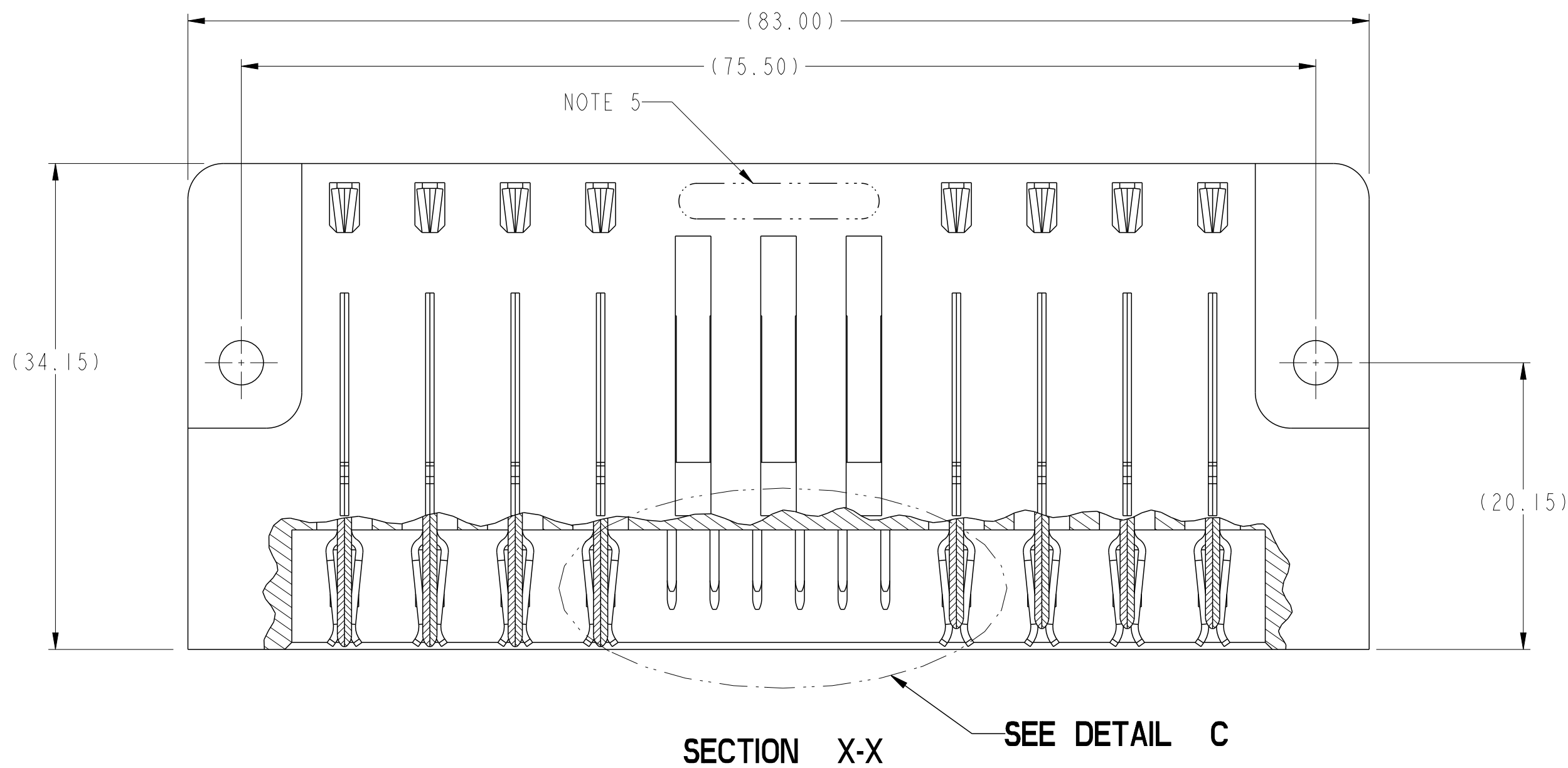
B

C

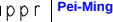
A

B

C



RETENTION CLIPS
OPTIONAL
(SEE P/N TABLE)

spec ref		-		dr		NotFound DuWa		2010/04/28		projection		MM		size		A2		scale		3:1			
tolerance std		-		eng		De-Ming Lu		2014/12/27						ecn no		ELX-DG-19849-1							
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		-		-						product family		HCL							
				appr		Pei-Ming Zheng		2014/12/29															
surface				linear		0.X		±0.5				title		R/A HDR ASSY 4P+24S+4P		HCL POWER CONNECTOR		dwg no		10077213		rev	
				0.XX		±0.25																	
				0.XXX		±0.10																	
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		www.fci.com		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 1 of 5							

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014

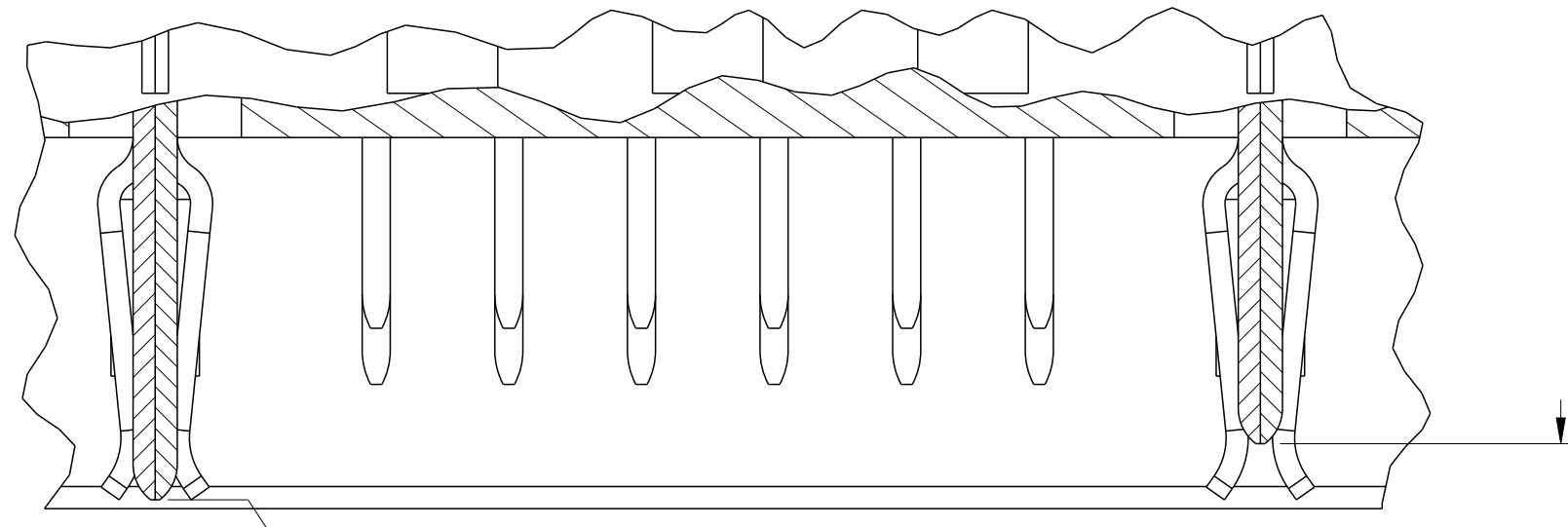
2

3

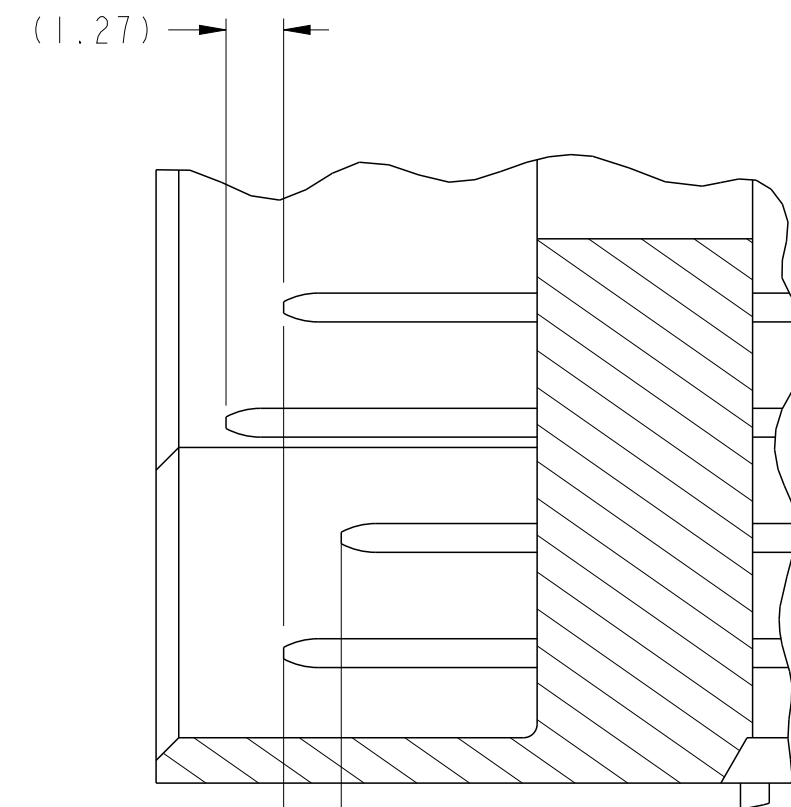
4

5

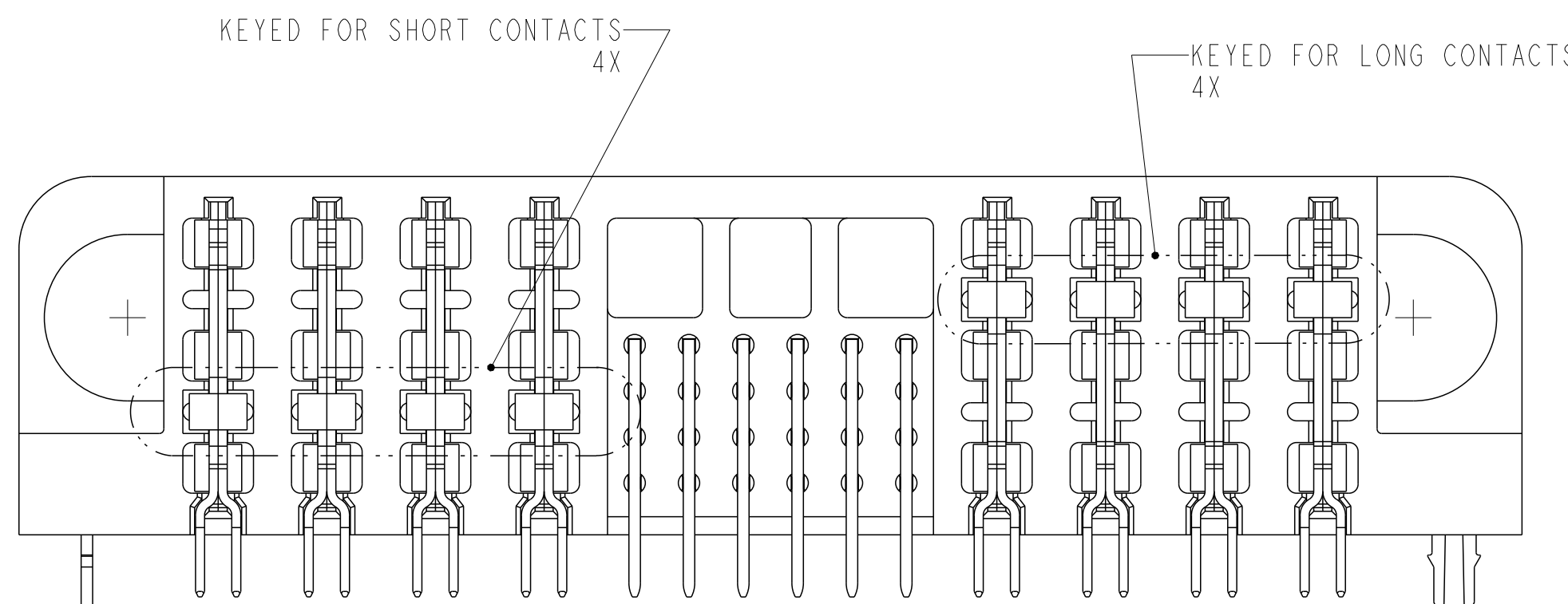
F



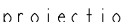
DETAIL C
SCALE 6:1
POWER MATING
SEQUENCE



SECTION W-W
SCALE 6:1
SIGNAL MATING
SEQUENCE



VIEW G-G

dr	NotFound DuWa	2010/04/28		MM		size	A2	scale	3:1
eng	De-Ming Lu	2014/12/27				ecn no	ELX-DG-19849-1		
chr	-	-				rel level			Released
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family			HCI			
	title	R/A HDR ASSY 4P+24S+4P				dwg no	10077213		rev
		HCI POWER CONNECTOR							
www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 2 of 5		

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014

NOTE 6

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 1 (HCI POWER) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	--	--	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	0.9 - 1.5um	--	0.70 - 0.80
	IMMERSION SILVER	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	0.15 - 0.65um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 9)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	--	0.70 - 0.80
GOLD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.003 - 0.007	FLASH UP TO 0.0002	--	--	0.69 - 0.80	
C	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE 2 (HPC SIGNALS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS							
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
	TIN-LEAD	1.125-1.175 (Ø.0453±.0010)	0.025-0.050	0.005-0.015	--	--	--	--	0.94 - 1.10 (Ø.040±.003)
	IMMERSION TIN			--	--	--	--	--	
	IMMERSION SILVER			--	--	--	--	--	
	COPPER (SEE NOTE 9)			--	--	--	--	--	
GOLD			--			--	--		
D									D
									E
									F
E									E
									F
F									F

1

2

3

4

5

6

7

8

PART NUMBER	RETENTION CLIPS	#4 SCREW	DIM A (TAIL LENGTH)	TAIL TYPE
I0077213-001LF	NO	YES	3.43	SOLDER TAIL
I0077213-002LF	NO	YES	4.70	SOLDER TAIL
I0077213-003LF	YES	NO	3.43	SOLDER TAIL
I0077213-004LF	YES	NO	4.70	SOLDER TAIL

NOTES:

1.

CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY

2.

CONTACT FINISH (ref GS-12-380 SECTION 5.2)

3.

PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-380.

4.

APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-070.

5.

PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.

6.

MINIMUM NOMINAL PCB THICKNESS: 1.6mm

7.

PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-1073.

8.

HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED,
OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.

9.

COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE
NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.

10.

ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.

11.

MOUNTING HOLES ARE UNPLATED.

FCI

Copyright FCI.

dr	Not Found DuWa	2010/04/28	projection MM	size	A2	scale	3:1		
eng	De-Ming Lu	2014/12/27		ecn no	ELX-DG-19849-1				
chr	-	-		rel level	Released				
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29		product family	HCI				
FCI www.fci.com			title	R/A HDR ASSY 4P+24S+4P HCI POWER CONNECTOR		dwg no	I0077213	rev	B
			cat. no.	-		Product - Customer Drw		sheet 5 of 5	

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9